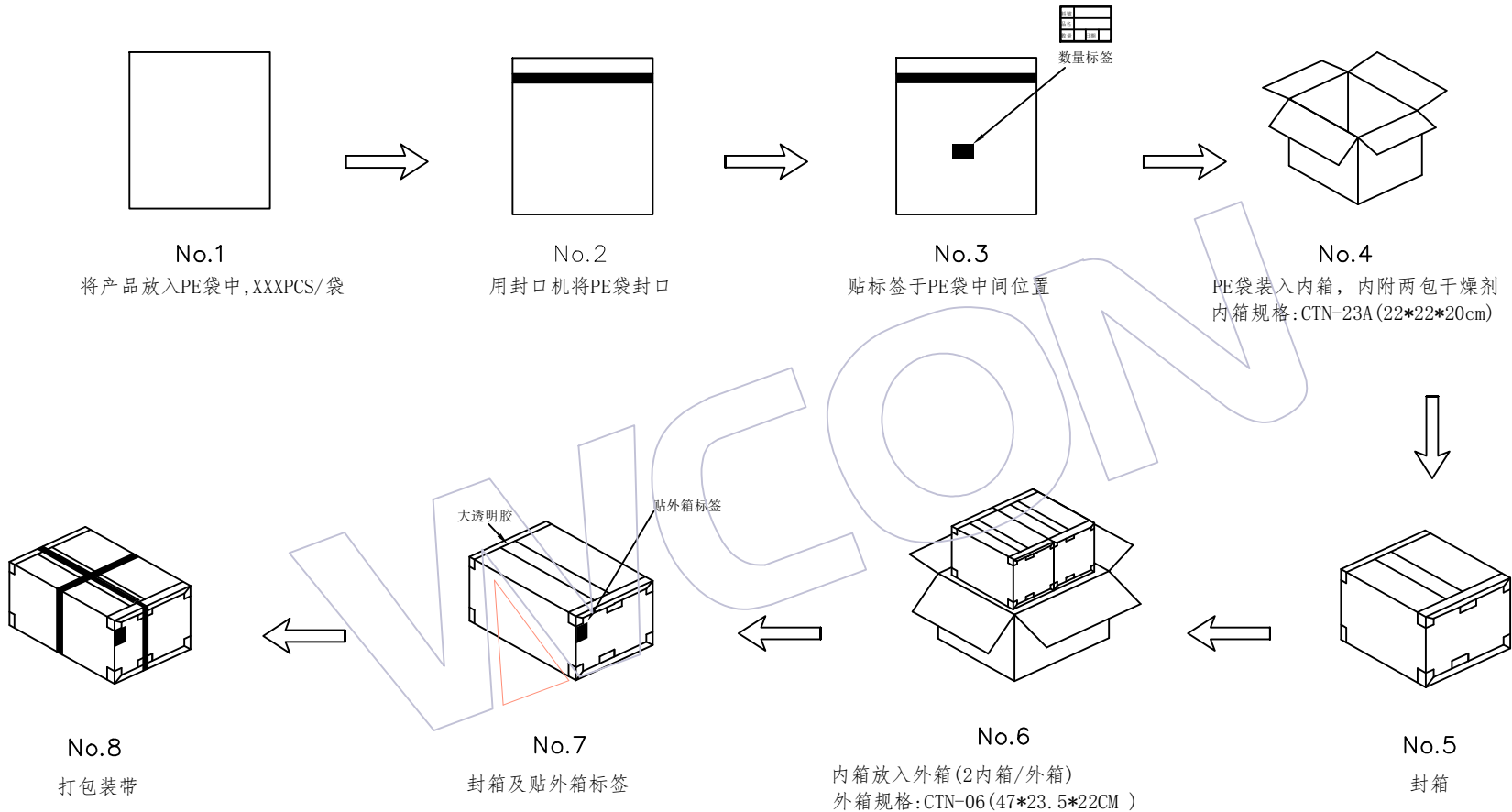


HSF



说明

1. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
2. 标签如客户有特殊要求,则按客户要求黏贴;
3. 打外箱包装带时需注意,打为十字型,另出国内客户,未打包装带。
4. 未尽事宜依据交货注意事项。

变更 记录						零件图		颜色	SCALE	1:1	 WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO. LTD 料号 PART NO. WF3965-WS (H) XXSXX01 品名 TITLE: 3.96mm Wafer, Male, Vertical DIP, XXP, 袋装规范			
						X.		材质	UNIT	mm				
						X.X	±0.10	设计	DESING	苏 珊		2023/03/16	SIZE	A4
						X.XX	±0.05	审核	CHECK				SHEET	1/1
						X.XXX	±0.02	核准	APPROVE				PROJ.	◆
	A0	2023/03/16	NEW			Angle								
	版次	日期	变更说明	变更	核准	X.	± 2'	核准						
	REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	DIM	TOL	APPROVE						